

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-038

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。

上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	62,430.31
减：募投项目使用总额	B	24,845.89
其中：2023年募投项目使用金额	C	7,449.45
减：银行手续费支出	D	
加：存款利息收入	E	584.86
加：理财收益	F	734.99
截至2023年12月31日募集资金结余金额	G=A-B-D +E+F	38,904.27
截至2023年12月31日募集资金银行账户余额	H	39,018.48
差异	K=H-G	114.21
其中：(1)拟置换的基本户及一般户支付募投项目人员费用		114.21

说明：募集资金结余金额与募集资金银行账户余额差异，系因公司使用基本户及一般户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，差异为尚未置换从募集资金账户支付的金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2022年10月27日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行，开立募集资金专户并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）截至2023年12月31日募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金余额	项目名称
深圳市 唯特偶	中国银行深圳分 行龙城支行	770576223416	0	补充流动资金

新材料 股份有 限公司	中国银行深圳分 行龙城支行	770576223416	2,125.61	微电子焊接材料研 发中心建设项目
	广发银行深圳分 行东滨支行	9550880059440800458	18,237.28	微电子焊接材料产 能扩建项目
	招商银行深圳分 行中心区支行	755903024810939	5.07	超募资金
	平安银行深圳分 行双龙支行	15385724350035	2,920.51	微电子焊接材料生 产线技术改项目
合计			23,288.48	

说明：除上述募集资金专户存储余额外，截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为15,730.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币24,845.89万元,其中2023年度使用7,449.45万元，募集资金实际使用情况可具体详见附件一。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司分别于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》，同意使用超募资金8,382.18万元追加投资“微电子焊接材料研发中心建设项目”，并新增项目实施地点，追加投资后项目建设地点为现有研发办公楼（原有）及惠州维佳化工厂（新增），实施主体不变；

公司于2023年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“微电子焊接材料生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年12月延长至2025年12月。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年12月31日，在首次公开发行股票募集资金到位前，已由公司利用

自筹资金先行实际投入募投项目人民币830.36万元，该拟置换的募集资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了(中兴华核字(2023)第010443)鉴证报告。

经公司第五届董事会第九次会议于2023年3月1日审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司于2023年3月8日-9日，已从募集资金专户将上述资金转至公司基本户或一般户，截至2023年12月31日上述资金已全部置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司实际募集资金中，超募资金人民币21,667.55万元。

公司分别于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》，同意使用超募资金8,382.18万元追加投资“微电子焊接材料研发中心建设项目”；

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,450.00万元用于永久补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司超募资金已累计永久补充流动资金人民币12,900.00万元，追加募投项目资金人民币8,382.18万元。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币

35,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

公司2023年10月25日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公司使用不超过人民币30,000.00万元闲置资金和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为人民币15,730.00万元。

除银行结构性存款外,其余募集资金存入于公司在银行开设的募集资金专户。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生募集资金投资项目的变更。募集资金投资项目追加投资情况见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年4月23日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		70,001.50			本年度投入募集资金总额					7,449.45
报告期内变更用途的募集资金总额		8,382.18			已累计投入募集资金总额					24,845.89
累计变更用途的募集资金总额		8,382.18								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.97%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、微电子焊接材料产能扩建项目	否	17,844.37	17,844.37	58.02	147.12	0.82%	2024 年 6 月	—	—	否
2、微电子焊接材料生产线技术改造项目	否	4,978.34	4,978.34	94.61	184.18	3.70%	2025 年 12 月	—	—	否
3、微电子焊接材料研发中心建设项目	是	7,940.05	16,322.23	846.82	1,614.59	9.89%	2026 年 6 月	—	—	否
4、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%		—	—	否
承诺投资项目小计		40,762.76	49,144.94	999.45	11,945.89					

超募资金投向										
1、补充流动资金				6,450.00	12,900.00					
2、追加募投项目资金（说明1）				8,382.18	8,382.18					
超募资金投向小计				14,832.18	21,282.18					
合计		40,762.76	49,144.94	15,831.63	33,228.07					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				<p>1、公司分别于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》，同意使用超募资金8,382.18万元追加投资“微电子焊接材料研发中心建设项目”；</p> <p>2、公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,450.00万元用于永久补充流动资金；</p> <p>截至2023年12月31日，公司超募资金已累计永久补充流动资金人民币12,900.00万元，追加募投项目资金人民币8,382.18万元。</p>						
募集资金投资项目实施地点变更情况				<p>公司分别于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金追加投资微电子焊接材料研发中心建设项目的议案》，同意使用超募资金8,382.18万元追加投资“微电子焊接材料研发中心建设项目”，并新增项目实施地点，追加投资后项目建设地点为现有研发办公楼（原有）及惠州维佳化工厂（新增）。</p>						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2022 年 12 月 31 日，募投项目先期投入 830.36 万元，其中“微电子焊接材料产能扩建项目”89.11 万元、“微电子焊接材料生产线技术改项目”89.56 万元、“微电子焊接材料研发中心建设项目”651.69 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已全部置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司在银行开立的募集资金专户，其中使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为 15,730.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
说明 1：超募资金追加募投项目 8,382.18 万元非本年实际投入的金额，因此本年实际投入募集资金（含超募资金永久补充流动资金）为 7,499.45 万元。	